JEITA 半導体システムソリューション技術委員会

従来の半導体製品における製品技術ではなく、
半導体を使用したシステム(アプリケーション)開発における
ソリューション技術を対象とする非競争領域の共同開発・技術の共有化および標準化活動を行う技術委員会を 2023年度に発足

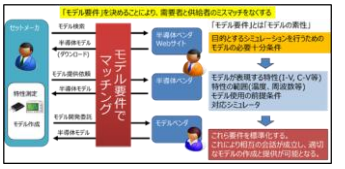
3サブコミティ(SC)、2プロジェクトグループ(PG)、1タスクグループ(TG)で構成

半導体標準化専門委員会

半導体システムソシューション技術委員会

ステアリング委員会

技術委員会のステアリング・運営・SC横断的な課題への対応

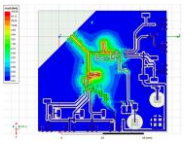


デバイスモデルDX推進SC

電子デバイスのシミュレーションモデルのアプリケーションノート標準化、流通・認証の枠組みを構築

半導体EMC-SC

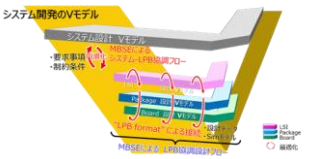
半導体EMCに関する国際標準化活動、システム(アプリケーション)上のEMCに関する規格の検証試験(妥当性、相関など)、半導体EMCの普及促進



トランシーバEMC特性評価

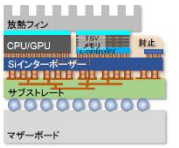
半導体&システム開発技術SC

半導体と半導体を使用したシステムの開発手法・設計手法の検討、その技術の情報展開・利用促進、及び設計情報フォーマットの標準化



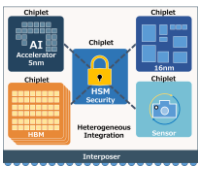
半導体構造設計SC

半導体のパッケージ・構造設計・実装技術の標準化活動・情報展開・啓発活動 (ﾁｯﾌﾟﾚｯﾄ・熱設計・材料物性情報・ｼｽﾃﾑﾒﾓﾘ技術含む)



チップレットソリューションPG (新設)

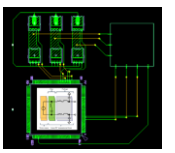
チップレット技術における必要な要件を調査し標準などを整備 (ヘテロジーニアスインテグレーション技術、ハードウェアセキュリティを含む)



チップレット技術を用いたSiP

パワエレ設計ソリューションPG (新設)

パワエレ機器及びそれに使用する半導体の協調設計手法を検討し開発にかかる期間とコストを最小化するために、効率を最大化する設計環境の考察・提案



車載eFuse規格審議TG (新設)

IEC SC47A に提案されている、車両低電圧電源ネットワーク用電子ヒューズ規格および関連規格を審議するタスクグループ

お問合せ先 ： 一般社団法人電子情報技術産業協会 事業戦略本部事業推進部担当: 岩渕・遠山
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 E-mail：device3@jeita.or.jp